

応用物理学会 集積化 MEMS 技術研究会主催

第3回集積化 MEMS 技術研究会 会告

集積化 MEMS は、次世代のデバイス・システムの成長原動力となる More than Moore 技術の 1 つとして、最近、注目を集めています。本研究会は、MEMS と LSI の両技術分野の融合と新たなテーマ開拓に向けて、材料、プロセス、デバイス構造、実装技術、高歩留まり技術、高信頼化技術などを視野に入れ、基礎研究から実用化に至るまでの様々な段階に関する活発な議論の場を提供します。

今回、第 3 回研究会を東北大学で開催するにあたり、LSI 側に軸足を置いた研究者からの講演を特集しました。また、マイクロナノマシニング研究教育センター、および江刺・小野・田中(秀)研究室の見学会も企画しますので、多くの方の御参加をお待ちしております。

(応用物理学会集積化 MEMS 技術研究会: 入会はこちら <http://annex.jsap.or.jp/MEMS/>)

【開催日時】平成 21 年 5 月 22 日(金)11:00~17:00

【開催会場】東北大学 マイクロナノマシニング研究教育センター 3 階セミナー室

〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-01

アクセス: <http://vbl.mech.tohoku.ac.jp/>

【参加方法】下記問い合わせ先に平成 21 年 5 月 10 日までにお申し込みください。

【参加費】A 会員(応物会員以外)、B 会員(応物会員)、賛助会員、学生、および入会手続き中の会員は無料、非会員は 4000 円

【見学会】11:00 までに研究会会場にお集まり下さい。

【懇親会】会場:こもれびカフェ(学内) 時間:17:15~19:00、会費:3000 円

【プログラム】

- 11:00~12:00 見学会(マイクロナノマシニング研究教育センター、および江刺・小野・田中(秀)研究室)
※研究会会場に 11:00 までにお集まり下さい。
- 12:00~13:05 昼食
- 13:05~13:15 委員長挨拶
- 13:15~14:00 「MEMS と LSI の融合:LSI 設計者の視点から」東北大学 室山 真徳
- 14:00~14:45 「RF CMOS 回路からみた MEMS 技術への期待」東京工業大学 石原 昇, 水落 裕, 益 一哉
- 14:45~15:00 休憩
- 15:00~15:45 「ISSCC での発表論文の解説と技術動向」NTT マイクロシステムインテグレーション研究所 重松 智志
- 15:45~16:30 「IEDM での発表論文の解説と技術動向」ソニー株式会社 コアデバイス開発本部 池田 浩一
- 16:30~17:00 「集積化 MEMS 技術と携帯機器」NTT ドコモ先進技術研究所 岡崎 浩司
- 17:15~19:00 懇親会

【問合せ先】事務局 e-mail: integMEMS2009@nano.pi.titech.ac.jp

◎申し込みは、下記情報をご記入後、電子メールにてお願いします。

応用物理学会 第 3 回集積化MEMS技術研究会 参加申込

氏名 _____

所属機関 _____

電子メール _____@_____

電話 _____

連絡先住所 〒 _____

研究会会員 会員 / 非会員 (会員番号: _____)

午前の見学会参加の有無: 参加 / 不参加

当日の研究会参加の有無: 参加 / 不参加

夕方の懇親会参加の有無: 参加 / 不参加